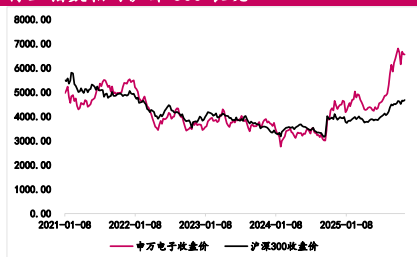


电子行业

2025 年 11 月 9 日

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
京泉华	35.96	48.41	97.42
可川科技	37.81	34.75	71.04
中富电路	72.20	29.41	138.21
伊戈尔	32.85	28.57	138.99
香农芯创	170.00	28.28	790.31
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
清越科技	6.78	-24.16	30.51
东尼电子	18.12	-16.38	42.12
杰华特	44.01	-12.28	198.19
捷邦科技	116.10	-11.57	84.42
传音控股	67.58	-11.43	777.97

行业指数相对沪深 300 表现



相关报告

【金元电子】周报 20250921HBM 高需求或抢占平面 DRAM 产能, 供需错配致使存储涨价

【金元电子】周报 20250928 云栖大会看点多, 硬件+平台开放助力国产 AI 芯片及模型落地

【金元电子】周报 20251012AMD 与 OPENAI 达成 6GW 协议, 开发互连技术 UALink 或加速渗透

【金元电子】周报 20251019 英伟达发布 800VDC 白皮书, “功率墙”应予以重视

【金元电子】周报 20251026 谷歌将量子优势的概念从随机任务推进到可重复验证、具备应用潜力的新阶段

分析师: 唐仁杰

执业证书编号: S0370524080002

电话: 0755-83025184

邮箱: tangrj@jyzq.cn

行业周度点评报告

—寒武纪优化基础软件平台, 或加速国产算力落地

评级: 增持 (维持)

- **全行业:** 本周上证指数上涨1.08%, 深证成指上涨0.19%, 沪深300指数上涨0.82%, 申万电子版块下降0.09%, 电子行业在全行业中的涨跌幅排名为25/31。板块个股涨幅前五名分别为: 京泉华、可川科技、中富电路、伊戈尔、香农芯创; 跌幅前五名分别为: 清越科技、东尼电子、杰华特、捷邦科技、传音控股。
- **电子行业:** 电子行业整体呈现震荡分化的格局, 板块表现冷热不均。从申万二级行业数据来看, 各板块涨跌互现。其中, 其他电子II板块表现最为强势, 周涨幅达到5.03%, 领涨全行业, 其下申万三级行业中其他电子III同样上涨5.03%, 延续良好走势。元件板块上涨2.14%, 表现相对稳健, 细分来看, 印制电路板上涨1.90%, 被动元件下跌3.25%, 分化明显。半导体板块整体持平, 但内部结构差异较大, 半导体设备子板块表现突出, 上涨4.80%, 分立器件上涨1.28%, 而模拟芯片设计与集成电路封测分别下跌3.56%与3.17%, 半导体材料下跌1.43%, 整体受结构性拖累。光学光电子板块微跌0.25%, 其中LED上涨1.07%, 光学元件下跌1.04%, 面板下跌0.45%, 板块整体仍显疲弱。消费电子板块下跌2.45%, 延续调整态势, 其中品牌消费电子下跌6.22%, 消费电子零部件及组装下跌2.11%, 对板块形成主要拖累。电子化学品II板块下跌0.82%, 电子化学品III子板块同幅下跌, 材料端表现平淡。总体来看, 本周电子行业涨跌分化明显, 其他电子与元件板块表现相对突出, 而消费电子与部分半导体细分领域仍承压, 行业整体呈现结构性调整态势。
- **行业要闻**
 - ◆ 安世中国再发声: 已建立充足库存, 可满足客户需求至年底
 - ◆ 蓝箭电子退出半导体产业投资基金, 终止共同出资事项
 - ◆ Supermicro携手英特尔与美光, 在量化交易性能测试中创世界纪录
 - ◆ 三星SDI与特斯拉洽谈LFP电池订单, 瞄准美国储能市场
 - ◆ 莱特光电前三季度营收净利双增, 国产OLED材料加速突破
- **公司动态:**
 - ◆ 飞凯材料: 2025年中期权益分派实施公告
 - ◆ 神工股份: 锦州神工半导体股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告
 - ◆ 歌尔股份: 2025年前三季度权益分派实施公告
 - ◆ 四会富仕: 关于吸收合并全资子公司的公告
 - ◆ 中英科技: 关于股东减持股份预披露的公告
- **投资建议:** 我们认为, 综合来看, 寒武纪自研基础软件平台 NeuWare 的这轮更新并非单点功能升级, 而是围绕主流框架与图编译、算子/通信库与工具链、以及集群可运维性的体系化补强。它将国产算力的价值主张从“硬件替代”推向“平台替代”, 为国内企业在模型迁移、性能优化、规模化部署与长期运维上提供了一条更现实、可落地的路线。随着在政务、运营商与互联网零售等场景的落地案例增多, 国产算力的口碑会加速反哺生态, 从而形成应用拉动研发、研发反哺应用的正循环。对国产 AI 模型而言, 这意味着可以更大胆地以“国产软硬件 + 国产模型”为主线来布局关键业务, 既兼顾成本与进度, 又兼顾安全与可控。随着国产硬件及软件平台加速自主化, 国产芯片的生态或得到强化, 国产算力或步入加入阶段。相关公司包括: 寒武纪-U、浪潮信息、海光信息、盛科通信-U、阿里巴巴、中芯国际等。
- **风险提示:** 1、国内AI硬件及基础平台落地不及预期: 国内AI硬件及基础平台研发仍处于早期阶段, 效果仍有待验证; 2、技术风险: AI硬件迭代周期较快, 新技术或对市场产生较大冲击; 3、产品导入不及预期: 新产品导入产业链需经过较长时间验证, 或导致公司业绩不及预期。

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前金元在先

目录

一、核心观点3

二、行业跟踪6

三、行业新闻8

四、公司公告14

五、下周重要事件提示20

图表目录

图 1：寒武纪训练软件平台3

图 2：寒武纪 MagicMind4

图 3：本周各行业版块涨跌幅6

图 4：本周电子版块：子版块涨跌幅7

图 5：电子板块历史走势8

图 6：电子板块历史市盈率8

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名6

表 2：本周电子版块个股跌幅前五名6

表 3：下周重要会议20

表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）23

一、核心观点

寒武纪更新基础软件平台进度，训推全栈打通到上游 PyTorch 与 Triton 内核语言。Cambricon NeuWare 是寒武纪专门针对其云、边、端的智能处理器产品打造的软件开发平台。其采用云边端一体、训推一体架构，可同时支持寒武纪云、边、端的全系列产品。寒武纪终端 IP、边缘端芯片、云端芯片共享同样的软件接口和完备生态，可以方便地进行智能应用的开发，迁移和调优。

图 1：寒武纪训练软件平台



数据来源：寒武纪，金元证券研究所

注：为清楚展示表格并剔除极值，图中纵坐标未完整展现

这次升级的核心是把训练/推理全栈打通到上游社区 PyTorch + Triton 内核语言。以 torch_mlu 原生对接社区 PyTorch，配合 Triton 至 Linalg 的编译链与自研算子/通信库（CNCL/CNCL），让模型迁移、定制算子与大规模集群部署更顺滑、维护成本更低、生态耦合更小。对中国本土“去 CUDA 化”路线是重大利好。

原生 PyTorch 对接，不再依赖长期维护的“定制版 PyTorch”，而是通过开源的 torch_mlu 作为设备后端，直接挂到社区版 PyTorch 上（2.4 起就是“社区 torch + torch_mlu 插件”的模式）。这一改变显著降低对上游版本的跟进成本，并改善开发/集成体验。另外，本次更新补全了国产算力芯片基础软件层的关键生态短板。从编译器/运行时（CNRT）、算子库（CNCL/CNCL）、编程语言（BANG-C/Triton）到推理引擎（MagicMind，基于 MLIR 图编译），形成对主流框架的“原

生式”承接，软硬件闭环明显强化

从平台内部结构看，MagicMind 是这次更新的“抓手”。它以 MLIR 图编译为核心，统一模型表示与优化通道，自动完成后端代码生成与算子融合，力图在不增加开发者负担的前提下逼近硬件上限。官方介绍与技术社群资料都强调了“训练到推理一键衔接”的目标。模型在 CPU/GPU/MLU 上训练完毕后，可经由图编译流水线快速部署到寒武纪全系 MLU 设备，并通过插件化机制满足不同客户在性能与功能上的差异化需求。

图 2：寒武纪 MagicMind



数据来源：寒武纪，金元证券研究所

与此同时，NeuWare 的底座组件更加齐整。CNRT 负责设备管理与任务运行时调度，CNCL 提供面向主流网络的高性能算子实现，CNCL 则覆盖分布式通信；再叠加 BANG-C/Triton 的双栈算子开发路径与 CNToolkit 等调试分析工具，开发闭环基本成形。官方开发者中心与开源仓库给出了系统化的手册、课程与算子示例，甚至包含性能基线、覆盖率与测例生成等“工程化细节”，这对企业自建“二次开发与性能优化体系”非常关键。更重要的是，寒武纪的 GitHub 组织保持活跃更新（例如 k8s 设备插件、监控导出器与 mlu-ops 的持续发布）。

在兼容性层面，本轮更新特别强调与最新 PyTorch 的对齐，以及以 Triton 为桥的自定义算子承接，这使 NeuWare 不再是另起一套栈，而是努力成为社区前沿的等价实现。对于已经在 CUDA/Triton 生态上沉淀的大模型与搜广推业务，迁移路径被压短。一类算子可以复用或平移到 BANG-C/Triton，另一

类则交由 MagicMind 的图优化与融合处理；加上 CNCL 的分布式通信与框架原生并行策略，企业可以在不改动业务抽象的前提下，较快完成从 PoC 到稳定上线的跨越。

从国产算力的角度看，首先是自主可控的研发与交付链条。当平台层能力被补齐，国产芯片不必再单点突破，而是形成了从模型开发、算子优化到分布式训练与推理部署的全流程；这不仅减少了对海外闭源栈的路径依赖，也让企业在采购、保密与合规方面拥有更灵活的议价空间。其次是研发效率与全生命周期成本。以 Triton/BANG-C 的双轨开发和 MagicMind 的自动化编译优化为核心，能够显著减少核心算子靠资深工程师手工堆料的人力瓶颈，使资源更聚焦在数据与业务抽象上，从而缩短 TTM 并降低算力 TCO。第三是同国产系统与本土智算中心的耦合。随着各地智算中心加速全国产芯落地，NeuWare 的工程化完善让“国产芯片 + 国产软件栈 + 国产模型”的组合获得真实的生产级验证，这对产业心智是极强的正反馈。

我们认为，综合来看，寒武纪自研基础软件平台 NeuWare 的这轮更新并非单点功能升级，而是围绕主流框架与图编译、算子/通信库与工具链、以及集群可运维性的体系化补强。它将国产算力的价值主张从“硬件替代”推向“平台替代”，为国内企业在模型迁移、性能优化、规模化部署与长期运维上提供了一条更现实、可落地的路线。随着在政务、运营商与互联网零售等场景的落地案例增多，国产算力的口碑会加速反哺生态，从而形成应用拉动研发、研发反哺应用的正循环。对国产 AI 模型而言，这意味着可以更大胆地以“国产软硬件 + 国产模型”为主线来布局关键业务，既兼顾成本与进度，又兼顾安全与可控。随着国产硬件及软件平台加速自主化，国产芯片的生态或得到强化，国产算力或步入加入阶段。

相关公司包括：寒武纪-U、浪潮信息、海光信息、盛科通信-U、阿里巴巴、中芯国际等。

风险提示：

1、国内 AI 硬件及基础平台落地不及预期：

国内 AI 硬件及基础平台研发仍处于早期阶段，效果仍有待验证；

2、技术风险：

AI 硬件迭代周期较快，新技术或对市场产生较大冲击；

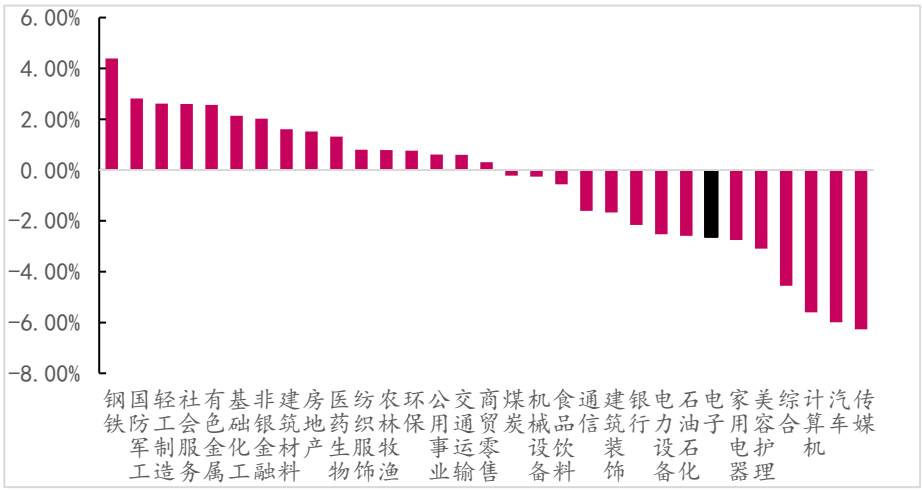
3、产品导入不及预期：

新产品导入产业链需经过较长时间验证，或导致公司业绩不及预期

二、行业跟踪

全行业：本周（2025. 11. 3-2025. 11. 7）上证指数上涨 1.08%，深证成指上涨 0.19%，沪深 300 指数上涨 0.82%，申万电子版块下降 0.09%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 25/31。板块个股涨幅前五名分别为：京泉华、可川科技、中富电路、伊戈尔、香农芯创；跌幅前五名分别为：清越科技、东尼电子、杰华特、捷邦科技、传音控股。

图 3：本周各行业板块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
002885.SZ	京泉华	48.41	35.96	24.88	37.36	167.85	387.58	121.28
603052.SH	可川科技	34.75	37.81	27.32	38.89	42.48	79.83	27.06
300814.SZ	中富电路	29.41	72.20	53.81	79.00	52.13	99.79	67.56
002922.SZ	伊戈尔	28.57	32.85	25.30	34.10	71.10	266.64	79.69
300475.SZ	香农芯创	28.28	170.00	126.64	184.88	41.13	182.90	276.65

数据来源：Choice，金元证券研究所

表 2：本周电子版块个股跌幅前五名

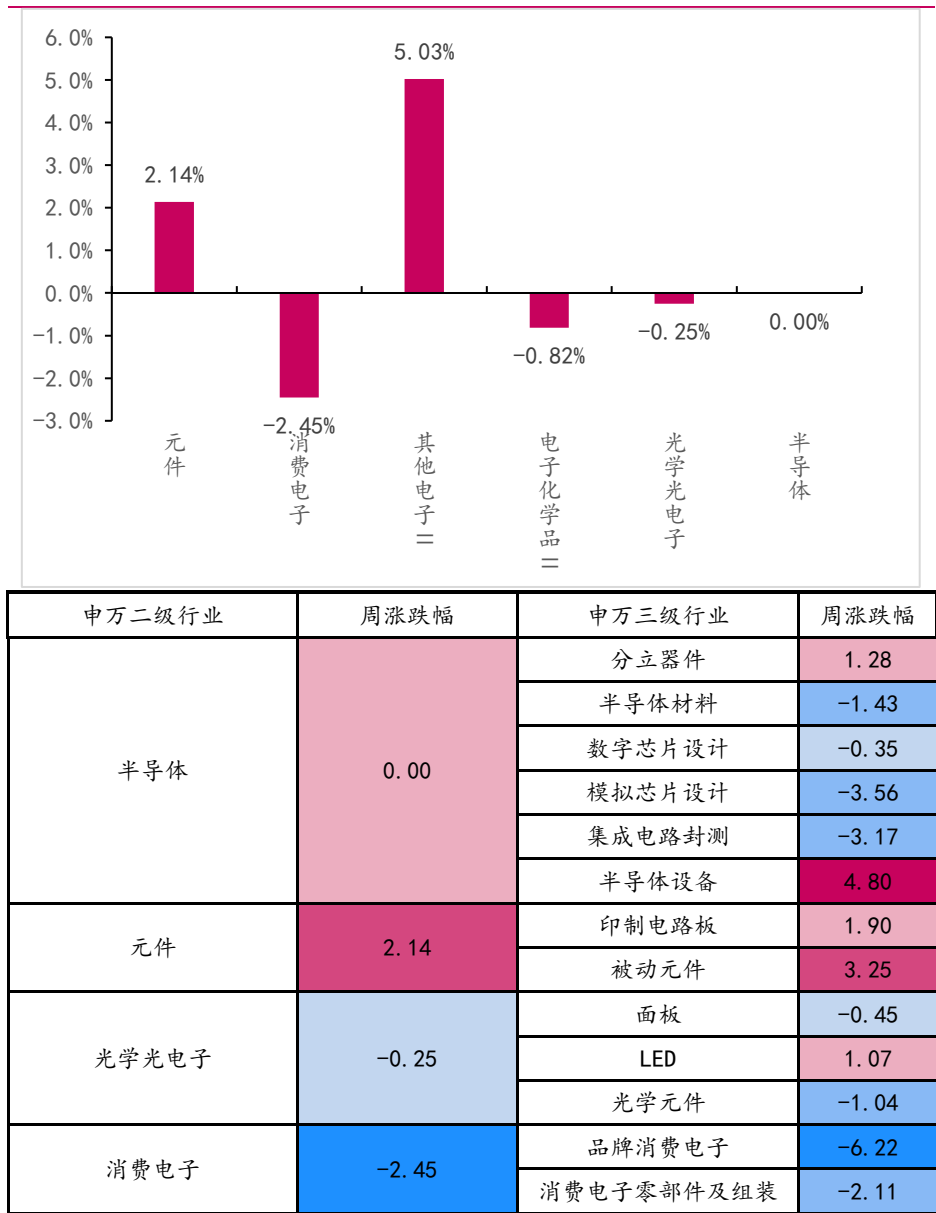
证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
688496.SH	清越科技	-24.16	6.78	6.26	7.15	39.78	94.65	6.20
603595.SH	东尼电子	-16.38	18.12	17.98	20.59	25.91	60.23	11.08
688141.SH	杰华特	-12.28	44.01	43.60	50.99	24.34	65.07	30.06
301326.SZ	捷邦科技	-11.57	116.10	114.24	130.68	29.72	8.12	9.78
688036.SH	传音控股	-11.43	67.58	66.88	76.21	6.34	73.01	51.83

数据来源：Choice，金元证券研究所

电子行业：本周（2025. 11. 3-2025. 11. 7）电子行业整体呈现震荡分化的格局，板块表现冷热不均。从申万二级行业数据来看，各板块涨跌互现。其中，其他

电子II板块表现最为强势，周涨幅达到5.03%，领涨全行业，其下申万三级行业中其他电子III同样上涨5.03%，延续良好走势。元件板块上涨2.14%，表现相对稳健，细分来看，印制电路板上涨1.90%，被动元件下跌3.25%，分化明显。半导体板块整体持平，但内部结构差异较大，半导体设备子板块表现突出，上涨4.80%，分立器件上涨1.28%，而模拟芯片设计与集成电路封测分别下跌3.56%与3.17%，半导体材料下跌1.43%，整体受结构性拖累。光学光电子板块微跌0.25%，其中LED上涨1.07%，光学元件下跌1.04%，面板下跌0.45%，板块整体仍显疲弱。消费电子板块下跌2.45%，延续调整态势，其中品牌消费电子下跌6.22%，消费电子零部件及组装下跌2.11%，对板块形成主要拖累。电子化学品II板块下跌0.82%，电子化学品III子板块同幅下跌，材料端表现平淡。总体来看，本周电子行业涨跌分化明显，其他电子与元件板块表现相对突出，而消费电子与部分半导体细分领域仍承压，行业整体呈现结构性调整态势。

图 4：本周电子版块：子版块涨跌幅



电子化学品	-0.82	电子化学品Ⅲ	-0.82
其他电子	5.03	其他电子Ⅲ	5.03

数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 5: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 6: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所

三、行业新闻

辉达独家获台积电A16产能，结合先进封装建构竞争天险

11月4日据TechNews科技新报报道，在人工智能芯片竞争日趋激烈之际，芯

片龙头辉达已独家取得台积电即将推出的A16制程产能。双方正针对A16节点进行联合测试，该制程采用奈米片电晶体和超级电轨技术，代表下一代高性能芯片路线。辉达计划以此生产下一代Feynman架构的GPU，预计于2028年推出。报道指出，A16制程对先进封装提出更高要求，特别是需增加矽穿孔通道以提升连结与散热能力。目前台积电的CoWoS封装产能供不应求，而辉达已预订2025年CoWoS-L年产能的约70%，几乎垄断高端AI芯片的封装资源。台积电正开发替代方案如CoPoS及晶圆级封装，以缓解供应压力。同时，随着HBM堆叠高度提升至12层甚至16层，混合键合技术将成为关键，进一步加剧封装产能紧张。业界认为，辉达凭借独占A16制程与庞大封装预留量，已在下一代AI芯片竞争中构筑极高壁垒，其它厂商只能通过创新封装和垂直整合策略寻求突破。

日商材料厂加速扩产，锁定2奈米与光阻剂市场

11月4日据TechNews科技新报报道，日本东京应化工业宣布将在韩国平泽投资200亿日元建设光阻工厂，预计2030年完工投产，产能将提升三至四倍，主要面向三星电子与SK海力士等客户。东京应化社长种市顺昭表示，公司正加快海外布局，以贴近客户厂区提供即时稳定的材料支持。光阻剂是决定芯片线宽与解析度的关键材料，日本厂商在全球市占率超过九成，长期保持技术领先。除光阻外，东京应化还计划在韩国追加120亿日元投资建设高纯化学品工厂，用于先进制程环节。另一家日商Adeka也宣布斥资32亿日元扩建金属氧化物光阻产线，将于2028年4月后启用。JSR公司亦在韩国布局同类产能。业界普遍认为，这一轮扩产反映日本材料企业正提前部署2奈米及更先进制程需求。根据普华永道预测，全球半导体材料市场规模将从2024年的720亿美元增至2030年的970亿美元，增长约35%，人工智能芯片带来的制程微缩与堆叠密度提升是主要驱动力。

人工智能热潮引爆三星暂停DDR5合约报价，结构性短缺冲击全球记忆体市场失序

11月4日据TechNews科技新报报道，在人工智能需求急剧上升和高带宽记忆体持续排挤效应下，全球DRAM供应链正陷入严重短缺。报道指出，三星电子自10月起暂停DDR5合约报价，SK海力士与美光随即跟进观望，导致下游厂商转向现货市场抢货，DDR5价格单月暴涨逾一倍。市场研究机构表示，DDR5现货价已从每颗7.68美元涨至15.5美元，未来季度报价可能持续两位数增长。慧荣科技总经理苟嘉章分析，此次短缺不同于以往的周期波动，而是多核心元件同时缺货所致。HBM芯片生产需消耗三倍于DDR5的晶圆产能，严重压缩了传统DRAM供给空间。随着全球云端巨头加大资本支出，AI推理需求在2026年预计将超过AI训练，对存储芯片的需求持续高涨。由于先进DDR技术扩产需耗资巨大且周期漫长，短期供需失衡难以缓解，议价焦点已从价格转向供货能力。业内预期，这种结构性短缺至少将持续到2026年，甚至可能延续至2027年。

安世中国再发声：已建立充足库存，可满足客户需求至年底

11月4日据爱集微报道，安世半导体中国有限公司发布客户公告称，针对荷兰安世半导体单方面宣布停止向东莞封测厂供货并指责中国团队违约的言论，公司强烈反对并指出相关说法纯属捏造。安世中国表示，荷兰总部目前拖欠

东莞工厂贷款约10亿元人民币，公司不存在任何违约行为。目前已建立充足的成品与在制品库存，能够稳定满足客户至年底及更长时间的订单需求，并已启动多套预案加快验证新晶圆产能，力争自明年起实现无缝衔接。业内人士认为，此举显示安世中国正积极强化本地供应链自主能力，以确保在复杂国际环境下维持运营稳定与客户信任。

谷歌DeepMind携手耶鲁大学推出新模型，破解癌细胞免疫弱点

11月4日据TechNews科技新报报道，谷歌旗下人工智能实验室DeepMind与耶鲁大学联合推出参数规模达270亿的新模型Cell2Sentence-Scale 27B，专门用于解析单细胞RNA数据，成功揭示癌细胞的免疫逃逸机制。研究发现，一种名为Silmitasertib的CK2抑制剂能够在特定信号条件下将“冷肿瘤”转化为“热肿瘤”，显著提升免疫系统识别能力。该成果首次通过实验验证AI生成假设的有效性，为免疫治疗提供了全新思路。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊表示，这项研究展示了人工智能在生命科学中的变革潜力，有望推动更精准的癌症疗法发展。模型及相关工具已在开源平台上线，方便全球科研人员共同推进后续研究。

蓝箭电子退出半导体产业投资基金，终止共同出资事项

11月4日据南方都市报报道，佛山市蓝箭电子股份有限公司发布公告称，决定退出与专业投资机构共同设立的股权投资基金“展速未来（嘉兴）股权投资合伙企业”，并已签署退伙协议。蓝箭电子原计划以自有资金出资2000万元，占基金认缴总额4110万元的近半份额，该基金由铜川普耀九州基金管理有限公司担任普通合伙人和管理人，投资方向聚焦半导体产业链上下游优质未上市企业。然而截至公告披露日，展速未来尚未实缴出资，也未在中国证券投资基金业协会备案。公司表示，鉴于市场环境变化及风险控制需要，经协商一致决定终止合作以降低投资风险和管理成本。蓝箭电子主营半导体封装测试业务，是华南地区主要的半导体器件生产基地之一。公司前三季度实现营收5.18亿元，同比增长2.55%，但净利润为亏损2650万元，同比下降逾280倍。公告指出，利润下滑主要受资产减值及存货跌价影响，三季度共计提减值准备1583万元。

三星加速导入1cDRAM设备，全力赶上HBM4量产时程

11月5日据TechNews科技新报报道，韩国三星电子正全面加速导入10奈米级第六代（1c）DRAM设备，目标在明年初启动HBM4量产，以追赶已率先与辉达签署供应协议的SK海力士。消息称，三星已在平泽园区完成第二厂1cDRAM设备建置，并同步在第三厂与第四厂导入新设备，逐步将旧制程产线改造为新一代1c制程。目前HBM4核心生产据点第四厂（P4）预计明年启用，公司正进行最终客户样品的内部可靠度测试，计划随后送交辉达进行GPU整合验证，若顺利明年下半年可正式出货。业界人士指出，HBM4良率目前仅约50%，尚未达到量产要求，三星正与韩美半导体合作强化堆叠与封装精度，目标将良率提升至70%以上。分析认为，三星的导入节奏紧扣辉达明年下半年发布新一代AI加速器Rubin的计划，能否在短期内实现稳定量产，将决定其在高频宽记忆体市场的竞争地位。

理学科技在台设立技术中心，深化“实验室到晶圆厂”战略布局

11月5日据TechNews科技新报报道，日本理学科技公司（Rigaku）在台湾举行子公司暨技术中心开幕仪式，宣布将以核心X光技术推动“实验室到晶圆厂”战略，强化半导体制程控制能力。集团总裁兼执行长川上润表示，Rigaku拥有超过70年技术积累，产品涵盖X光分析仪器、雷射光谱仪及热分析设备，其关键组件均在日本、美国及东欧工厂自制，确保品质一致。此次落地台湾，是Rigaku在亚洲高科技产业链布局的重要一步，旨在结合当地晶圆制造生态与自身检测技术，提供客户从实验研发到量产制程的整合解决方案。公司认为，随着半导体微缩化与复杂制程的加深，X光检测在材料结构分析、缺陷追踪与质量验证中的作用日益关键。

Supermicro携手英特尔与美光，在量化交易性能测试中创世界纪录

11月5日据TechNews科技新报报道，美国Supermicro公司宣布与英特尔、美光联合，在纽约举行的STAC峰会中于STAC-M3量化交易基准测试中创下多项世界纪录。该测试由独立金融科技机构STAC主办，模拟银行与对冲基金的高频交易与风险管理情境，用以评估数据处理、存储与网络综合性能。此次测试显示，Supermicro与合作伙伴在Antuco与Kanaga两大系列共计24项指标中取得19项纪录，平均响应时间与吞吐量均刷新历史最佳水平。公司高级副总裁Vik Malyala表示，这一成绩证明其高性能伺服器架构与合作生态的领先优势，未来将持续优化低延迟、高数据密度环境下的AI与金融计算解决方案。

三星SDI与特斯拉洽谈LFP电池订单，瞄准美国储能市场

11月5日据TechNews科技新报报道，韩国电池制造商三星SDI正与美国电动车巨头特斯拉洽谈磷酸铁锂（LFP）电池供应协议，预计未来三年供应量可达10 GWh，主要用于特斯拉的储能系统。若协议达成，电池将由三星SDI与Stellantis在印第安纳州的合资工厂生产，最早于2027年交付。特斯拉过去主要使用中国宁德时代等企业的LFP电池，但随着美国推动“锂电池供应去中化”政策，三星SDI成为潜在替代供应商。业内指出，三星SDI与竞争对手LG新能源均计划在美国量产棱柱形LFP电池，抢占未来本土储能市场份额。

大型资料中心用电纳入审查，能源署强化5MW以上能效管理

11月5日据TechNews科技新报报道，因应人工智能与云计算产业用电快速攀升，台湾经济部能源署宣布修订《能源开发与使用评估准则》等法规，要求能源使用量达5MW以上的超大型及主机代管资料中心，在新设或扩建阶段须采用最佳节能技术，并提交能源使用规划接受审查。能源署表示，此举参考欧盟资料中心能效标准，设定电力使用效率（PUE）指标，超大型资料中心须低于1.3，主机代管中心须低于1.4。未来将结合专家评估与企业咨询机制，推动冷却、电力、监控与软件系统全面节能化。官方认为，该举措有助降低电网负荷、减少碳排，并提升台湾在高能耗数字基础设施领域的国际竞争力。

莱特光电前三季度营收净利双增，国产OLED材料加速突破

11月5日据中国证券报报道，陕西莱特光电材料股份有限公司发布2025年第三季度报告，前三季度实现营业收入4.23亿元，同比增长18.77%；净利润1.8亿元，同比增长38.62%。公司表示，业绩增长主要受OLED终端材料销售提升带

动。作为国内OLED核心材料龙头，莱特光电已实现Red Prime、Green Host、Red Host等材料国产化，突破海外专利封锁。截至今年6月底，公司累计申请专利1030件、授权384件，并加大AI+材料研发投入。公司目前与多家头部面板厂建立长期合作，产品已应用于华为、荣耀、OPPO、VIVO等品牌。莱特光电持续加码分红与回购，正通过技术创新和资本运作加速推动OLED材料国产化进程。

华邦电总经理看好记忆体市场前景，结构性缺口将推升长期需求

11月6日据TechNews科技新报报道，记忆体大厂华邦电总经理陈沛铭表示，随着终端需求复苏与制程升级，公司DRAM业务创下近三年新高。第三季度DRAM营收季增18%、年增33%，20奈米制程成为主要成长动能，占总出货量37%。陈沛铭指出，全球DRAM市场正经历结构性供需失衡，因先进制程无法再支持DDR3和DDR4，迫使主要厂商转向DDR5生产，导致DDR4出现长期供应缺口，价格或持续上升至2027年。华邦预计第四季营收、出货与ASP将同步增长，并透过强化SLC NAND与车用、工业市场布局维持领先。

日月光发布AI增强平台IDE 2.0，大幅缩短封装设计周期

11月6日据TechNews科技新报报道，日月光半导体宣布推出AI增强整合设计生态系统IDE 2.0平台，显著提升晶片封装设计效率与准确性。IDE 2.0整合云端模拟与AI预测分析，可在数小时内完成原需数周的设计迭代，实现风险即时评估与多物理场协同模拟。日月光研发副总洪志斌表示，新平台可将设计时间缩短90%，在电性、热应力与可靠性方面实现高精度模拟，并助客户快速建模与优化设计。公司称IDE 2.0是VIPack先进封装生态的重要组成，标志封装架构在AI时代迈入智慧化阶段。

Arm重申不主动自研晶片，AI需求持续增长未见泡沫迹象

11月6日据TechNews科技新报报道，Arm策略与生态系执行副总裁Drew Henry在台受访时强调，公司不会主动开发自家晶片，所有行动均依合作伙伴需求而定。Arm专注提供运算架构与设计支持，协助客户如AWS、特斯拉等企业打造自研晶片，以满足AI与特定运算需求。Henry表示，AI带动医疗、制药及生产力领域创新，当前并未出现泡沫化迹象。随着AI应用扩张，全球GDP增速有望倍增。Arm也将持续与台积电、英特尔等厂商合作，强化生态系统协同，巩固其在AI运算架构领域的核心地位。

Google推出Project Suncatcher，拟建太空TPU资料中心

11月6日据TechNews科技新报报道，Google宣布探索以太阳能驱动的卫星AI资料中心计划“Project Suncatcher”，目标在轨道上建立以TPU为核心的分布式计算网络。该项目利用自由空间光学连结技术，将低轨卫星串联成高带宽运算网络，发电效率较地面高出8倍，可实现全天候能源利用。Google表示，第六代Trillium TPU已通过辐射耐受测试，计划与Planet Labs合作，于2027年前发射原型卫星验证技术。公司认为，太空资料中心将成为AI计算扩展与绿色能源结合的新方向。

苹果拟每年支付10亿美元采用Google Gemini模型升级Siri

11月6日据TechNews科技新报报道，苹果正与Google洽谈合作，计划每年支付约10亿美元使用其1.2兆参数的Gemini大型AI模型，为Siri提供资讯摘要与任务规划功能。该模型将部署于苹果Private Cloud Compute伺服器中，与Google基础架构隔离，以保障用户隐私。Gemini预计自2026年起支援Siri核心功能，提升语义理解与复杂任务处理能力。苹果执行长库克此前曾表示，公司正考虑开放更多AI模型选项，Gemini合作为Safari搜索协议后两巨头再度携手。苹果同时加快自研AI模型开发，计划明年推出自家1兆参数系统以减少外部依赖。

荷兰安世半导体回应供应链恢复进展，否认张学政恢复CEO职务

11月6日据界面新闻报道，荷兰安世半导体官网当地时间11月5日发布声明称，公司欢迎美国当局暂停实施所谓“穿透规则”一年，以及中国方面推动恢复安世中国及其代工厂出口的举措，认为此举有助于确保关键成熟制程芯片供应全球市场。公司表示，期待进一步了解放宽出口限制的条件与程序。安世指出，自10月29日起因安世中国拒付晶圆款，公司暂停其晶圆直接供应，但并未完全中止晶圆运输，目前欧洲及亚洲其他工厂运营正常。同时，公司否认张学政恢复CEO职务，强调包括业务迁移与高管任免在内的重大决策须经荷兰政府批准，并将持续一年。

蒋尚义：AI推动半导体新周期，小晶片与先进封装成未来关键

11月7日据TechNews科技新报报道，鸿海科技集团董事蒋尚义在“2025远见高峰会”上指出，AI已成为驱动半导体发展的新引擎，未来将从资料中心迈向边缘运算（AIoT），带动上万种应用场景。他认为传统制程升级成本高昂且难以为多元AI应用带来规模经济，小晶片（Chiplet）架构将成为关键解方，可模块化设计并分摊开发成本。蒋尚义强调，摩尔定律逼近极限，半导体突破口将转向先进封装，如CoWoS、InFO等技术将成为效能提升主力。他指出，台湾在制造与封测仍具领先优势，但未来竞争焦点将转向系统设计，谁掌握系统架构，谁就主导产业发展。

日本10兆日圆半导体计划加码，Rapidus获巨额补助谋求翻身

11月7日据TechNews科技新报报道，日本政府宣布将在2030财年前投入10兆日圆支持半导体与AI产业，以重塑在全球供应链中的核心地位。政府计划通过补助Rapidus公司开发2奈米制程，并为晶片设计、资料中心、自动驾驶等领域提供研发资金。今年已拨款8000亿日圆支援Rapidus研发与运营，并设立1600亿日圆专项基金扶持晶片设计企业。Rapidus目标2027年实现量产，正与IMEC及IBM合作技术开发。自民党前干事长甘利明与首相石破茂均表示，日本必须在半导体关键领域重新崛起，带动未来十年吸引超过50兆日圆的社会总投资。

Sandisk发布全球最小1TB USB-C随身碟，主打高速与便携兼顾

11月7日据TechNews科技新报报道，Sandisk推出全球最小的1TB USB-C随身碟Extreme Fit USB-C Flash Drive，读取速度最高达400MB/s，主打商务与学生族群。该随身碟具备紧密贴合设计，可长期插入笔电或平板使用，并支援Windows与Mac系统。产品搭配SANDISK Memory Zone应用，可快速管理与备份

档案。Sandisk全球品牌总监Christina Garza表示，这款产品旨在满足现代移动办公需求，让用户在通勤、会议或课堂间实现即插即用的高效工作体验。该系列提供64GB至1TB多种容量，售价329至2999元。

网际网络发明者警告AI威胁网络经济，广告模式或被颠覆

11月7日据TechNews科技新报报道，网际网络发明者提姆·伯纳斯-李爵士在伦敦《金融时报》未来AI高峰会上表示，生成式AI与大型语言模型正威胁支撑全球网络经济的广告模式。随着用户直接从AI模型获取资讯，传统依赖点击量的网页广告收入或将崩塌。他指出，大型科技企业正集中掌握数据与收益，网络开放性被削弱。伯纳斯-李呼吁建立国际合作监管机构，引导AI技术发展，并恢复个人数据控制权。他警告，若不及时调整，网络可能从自由平台演变为少数巨头垄断的数据生态。

OpenAI与Perplexity涉绕过付费墙访问新闻内容，惹版权争议

11月7日据TechNews科技新报报道，《哥伦比亚新闻评论》发布报告指出，OpenAI的ChatGPT Atlas与Perplexity的Comet等AI浏览器可模拟人类用户，绕过网站付费墙读取仅限订阅者的内容。报告显示，这些工具成功访问MIT科技评论9,000字的专属文章，而传统ChatGPT则被封锁。尽管部分浏览器避免直接读取涉诉出版商的内容，但其抓取行为已引发媒体版权担忧。随着AI浏览器市场快速扩张，媒体业者警告此举或削弱新闻机构的商业模式，并要求监管机构介入界定AI取用新闻内容的合理边界。

通宝光电冲刺北交所IPO，大客户依赖与产能消化成关键考验

11月7日据深圳商报报道，常州通宝光电股份有限公司拟登陆北交所，其首发事项将于11月13日上会。公司主营汽车照明、电子控制与能源管理系统，近年来营收稳步增长，但客户集中度极高、产能利用率下滑及新业务盈利承压引发关注。招股书显示，公司2022年至2025年上半年营收由3.90亿元增至3.29亿元，2025年预计全年营收6.8亿至7.8亿元，同比增长最高可达32.7%，但净利润增长有限，主要因广西新基地投产初期亏损及新产品毛利为负。报告期内，上汽通用五菱为公司最大客户，销售占比最高达93.45%，客户依赖度进一步加剧。公司警示，若主要客户需求下降或合作不稳定，将对业绩造成不利影响。此外，公司计划募资3.3亿元投向新能源汽车LED模组与充配电系统项目，但市场对新增产能能否顺利消化仍存疑虑。北交所已要求公司进一步说明产能规划合理性及客户支撑情况。

四、公司公告

飞凯材料:2025年中期权益分派实施公告

公司11月4日发布公告，上海飞凯材料科技股份有限公司宣布实施2025年中期权益分派方案，以总股本566,946,450股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计分红金额约2267.79万元，不送红股也不进行资本公积转增。本次权益分派的股权登记日为11月10日，除权除息日为11月11日。公司表示，现金红利将通过中国结算深圳分公司于11月11日划入股东账户，自

派股东飞凯控股有限公司的红利由公司自行派发。分红实施后，公司将根据限制性股票激励计划的相关规定，对激励股票授予价格进行相应调整并另行公告。

龙腾光电：龙腾光电关于拟公开挂牌出售全资子公司股权的提示性公告

公司11月4日发布公告，昆山龙腾光电股份有限公司宣布拟通过公开挂牌转让方式出售其全资子公司昆山龙腾电子有限公司100%股权，以推进全球战略布局、优化资源配置并提升运营效率。本次交易在产权交易机构进行信息披露，尚未确定受让方及交易价格，不构成交易行为，也不构成重大资产重组。龙腾电子注册资本6.16亿元，截至2025年9月末资产总额约4.76亿元，净资产约4.70亿元，前三季度净亏损943.56万元。公司表示，股权转让价格将以经国资监管部门核准或备案的评估结果为基础，挂牌价格不低于评估值，最终以公开竞价结果为准。该交易有助于提高资源使用效率和经营效益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，但仍需获得相关国资部门批准，交易能否达成存在不确定性。

炬光科技：西安炬光科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

公司11月4日发布公告，西安炬光科技股份有限公司披露已于11月4日首次向2025年限制性股票激励计划的激励对象授予第二类限制性股票324.00万股，授予价格为每股120.80元，共计94名员工获授，标的来源为向激励对象定向发行的A股普通股；本次激励计划有效期不超过60个月，首次授予部分自授予之日起满12个月开始分三期归属，归属比例依次为30%、30%、40%，归属日须避开定期报告披露前窗口期及重大事项敏感期；公司与监事会已按规定完成审议、公示及股东大会授权，董事会认为授予条件已成就，薪酬与考核委员会、以及出具法律意见的北京锦路安生（西安）律师事务所均确认本次授予符合《股权激励管理办法》《科创板上市规则》及公司《激励计划（草案）》；公司称本次激励旨在提升员工积极性与运营效率，不会损害公司及全体股东利益，并将按规定持续履行信息披露义务。

神工股份：锦州神工半导体股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

公司11月4日发布公告，锦州神工半导体股份有限公司称持股5%以上股东更多亮照明有限公司持有公司37,003,560股，因自身发展需要，计划自公告披露之日起15个交易日后的90日内减持不超过3,406,114股，不超过总股本2%，其中集中竞价减持不超过1%、大宗交易减持不超过2%，减持区间为2025年11月26日至2026年2月25日；若期间发生派息、送股、转增、配股等事项将相应调整数量；该股东无一致行动人、上市以来未减持，本次计划与其上市时所作锁定及减持承诺一致；公司提示减持方式、时间、价格及数量存在不确定性，本次减持不涉及控制权变更，公司将按进展依法披露，提醒投资者注意风险。

歌尔股份：2025年前三季度权益分派实施公告

公司11月4日发布公告，歌尔股份有限公司宣布实施2025年前三季度权益分派方案。根据2024年度股东大会授权及董事会决议，公司将以截至股权登记日的总股本扣除回购专用账户中回购股份后3,472,073,440股为基数，向全体股

东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年11月11日，除权除息日为11月12日，红利将由中国结算深圳分公司于11月12日通过托管机构发放。因公司回购股份不参与分配，实际现金分红总额为5.208亿元，对应每股现金红利0.1468875元，实施后公司股本保持不变。差异化税率将依据投资者持股期限执行，持股超过一年免税。本次权益分派方案符合股东大会授权，期间公司股票期权激励已暂停行权。公告同时说明，分红实施后股票期权的行权价格将作相应调整。

中英科技:关于股东减持股份实施情况公告

公司11月5日发布公告，常州中英科技股份有限公司披露股东常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）已完成此前披露的减持计划。中英汇才作为公司控股股东及实控人的一致行动人，原持有公司2,436,000股，占比3.2394%，计划通过集中竞价方式减持不超过118,300股。实际减持期间为2025年8月6日至8月13日，共减持98,200股，占公司总股本0.1306%，成交均价为42.93元/股，区间价格介于42.80至43.20元之间。减持后其持股降至2,337,800股，占总股本3.1088%，股份均为无限售条件流通股。公司表示，股东在减持过程中严格遵守《证券法》及深交所相关减持规则，实施情况与预披露内容一致，不存在违规或违反承诺情形，本次变动不会导致公司控制权变化或影响公司治理结构与持续经营。

翰博高新:关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份的预披露公告

公司11月5日发布公告，翰博高新材料（合肥）股份有限公司披露部分董事、高级管理人员及特定股东的股份减持计划。董事兼副总经理蔡姬妹女士持有公司0.17%股份，拟自公告披露15个交易日后3个月内通过集中竞价方式减持不超过75,000股，占总股本0.04%；股东可传丽女士持有0.06%股份，拟减持不超过101,250股；股东许永壮先生持有0.02%股份，拟减持不超过40,500股，减持期间为2025年11月27日至2026年2月26日。三人减持原因均为个人资金需求，所持股份均源自2023年6月从安吉赛维特企业管理合伙企业非交易过户所得。公告指出，安吉赛维特已注销，其合伙人将继续遵守此前所作的锁定和减持承诺，包括锁定期12个月及减持比例上限等要求。公司强调，本次减持不会导致控制权变更或影响公司治理与经营，减持计划符合《公司法》《证券法》及深交所相关监管指引，股东将依法依规执行并及时披露进展，提醒投资者关注风险。

四会富仕:关于吸收合并全资子公司的公告

公司11月5日发布公告，四会富仕电子科技有限公司拟吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公司，以进一步优化管理架构、降低管理成本并提升资产整合效率。富仕技术成立于2020年，注册资本2亿元，截至2025年9月30日总资产约1.05亿元、净资产约8758万元，尚处建设期且未开展具体经营活动。本次吸收合并完成后，富仕技术的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债及权利义务由母公司承继，公司名称、经营范围、注册资本及管理层结构均保持不变。合并事项尚需提交股东大会审议通过，公司将依法履行债权人通知和公告程序，并授权管理层负责协议签署及相关手续办理。公告指出，该吸收合并不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，符合公司长期发展战略

及股东整体利益。

北方华创:关于开立募集资金暂时补充流动资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告

公司11月5日发布公告,北方华创科技集团股份有限公司表示,其全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司已开立募集资金暂时补充流动资金专项账户,并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司北京东单支行签署《募集资金三方监管协议》。公告指出,公司于2021年非公开发行A股募资总额约85亿元,扣除费用后净额约84.52亿元,资金主要用于半导体装备扩产、高端研发及补充流动资金等项目。根据2025年10月30日董事会审议结果,公司同意北方华创微电子使用不超过12.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。此次专项账户仅用于主营业务相关的生产经营支出,资金专户实行严格监管,保荐机构可随时查阅账户信息,银行按月出具对账单并报告大额支取情况。公司强调,该协议严格遵循深交所募集资金监管指引,确保募集资金安全、规范使用,维护投资者合法权益。

隆扬电子:关于2025年三季度权益分派实施的公告

公司11月5日发布公告,拟实施2025年三季度权益分派:以总股本283,500,000股扣除回购专户已回购975,600股后的282,524,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),合计派发33,902,928.00元,不送红股、不转增;按股权登记日总股本折算的每10股现金红利为1.195870元,除权除息参考价为股权登记日收盘价减0.1195870元;股权登记日为2025年11月11日,除权除息日为11月12日,深股通及境外机构等适用10%预提税,个人投资者按持股期限差别化征税;A股现金红利由中国结算深圳分公司代派,隆扬国际股份有限公司与昆山群展商务咨询合伙企业(有限合伙)两户由公司自派;同时据首次公开发行时相关承诺条款,本次分红后最低减持价格由21.10元/股相应调整为20.98元/股;公司提示已获2024年年度股东大会授权并经2025年10月28日董事会审议通过,相关参数将同步用于限制性股票激励计划价格调整并另行披露。

必易微:必易微关于开立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

公司11月6日发布公告,深圳市必易微电子股份有限公司披露其全资子公司上海必易微电子技术有限公司已开立募集资金专项账户,并与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公告指出,公司此前首次公开发行股票共募资9.52亿元,扣除费用后净额为8.61亿元,专项用于“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”等募投项目。为配合新增实施主体与实施地点,公司董事会授权管理层办理相关专户事宜,新开账户用于该项目资金的存储与使用。截至2025年10月30日,该账户余额为零,资金专款专用。监管协议明确银行按月出具对账单、保荐机构可随时查询账户情况,并在大额支取或异常情形下履行报告义务。公司表示,本次协议内容上交所范本一致,旨在强化募集资金规范管理与透明监督,保障投资者权益。

闻泰科技:关于股东减持股份计划公告

公司11月6日发布公告,持股7.77%的股东无锡国联集成电路投资中心,拟因自身经营安排减持闻泰科技股份有限公司股份不超过3733.91万股,占总股本3%。其中,大宗交易方式减持不超过2489.27万股,占总股本2%,集中竞价方式减持不超过1244.64万股,占总股本1%,减持期限为2025年11月27日至2026年2月26日,减持价格将视市场情况确定。该股东所持股份来源于公司发行股份购买资产取得,均为无限售流通股,并已履行完毕2019年重大资产重组期间作出的锁定承诺。公司指出,本次减持计划不会导致控制权变更,股东将在减持期间根据市场情况自主决定是否实施并依法履行信息披露义务。

一博科技:关于股东减持股份至5%以下并触及1%整数倍的公告

公司11月6日发布公告,深圳市一博科技股份有限公司披露,股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)在此前披露的减持计划期间内,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份156.94万股,占公司总股本的0.7490%,其持股比例由5.7490%降至4.99999%,持股比例降至5%以下并触及1%整数倍。减持后,领誉基石持有公司股份1047.68万股,不再为公司持股5%以上股东。公告指出,该股东此前已于7月21日披露减持预案,计划减持比例不超过3%,本次实际减持与计划一致,未违反相关承诺及监管规定。本次权益变动不会导致公司控制权变更或对持续经营产生重大影响,公司将持续关注减持计划后续执行情况。

华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

公司11月6日发布公告,江苏华海诚科新材料股份有限公司表示,其于当日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》。公告显示,公司2024年限制性股票激励计划此前已履行完备的董事会、监事会及股东大会审议程序,并完成首次授予与预留授予。此次作废系因一名首次授予激励对象去世,需作废已授予但尚未归属的限制性股票0.80万股。公司指出,本次作废股份数量较小,不会对公司经营状况及股权激励计划的正常实施造成重大影响。董事会薪酬与考核委员会及律师事务所均认为,本次作废符合《管理办法》及激励计划草案等相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

苏大维格:关于收购常州维普半导体设备有限公司51%股权暨关联交易的公告

公司11月6日发布公告,苏州苏大维格拟以自有或自筹资金5.10亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权,交易完成后常州维普将纳入合并报表;由于转让方中的深创新资本与红土一号与公司5%以上股东同属深圳市创新投资集团控制,因此本次构成关联交易,已获董事会审议通过并将提交2025年第三次临时股东会审议;该交易不构成重大资产重组,评估基准日2025年6月30日标的股东全部权益评估值为9.98亿元,依据收益法,交易定价按常州维普100%股权价值10亿元协商确定;协议约定现金分期支付并设置业绩承诺与补偿机制,创始股东承诺2025-2027年累计净利润不低于2.4亿元,未达成须以现金或所购苏大维格股票补偿;交割后苏大维格提名标的公司5名董事中的3名并委派副总经理、财务总监和仓储管理负责人,创始股东将以其所得对价

的30%于规定期限内增持苏大维格股票且在业绩补偿履行前限售质押。

则成电子:持股5%以上股东拟减持股份不超过2%的预披露公告

公司11月7日发布公告,持股9.83%的股东深圳市海汇聚成投资管理企业计划因合伙人资金需求,在公告披露15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过2%的公司股份,即最多减持276.72万股,减持价格将根据市场情况确定且不低于公司上市发行价;若公司在减持期间发生送红股、转增股本等事项,减持数量将作相应调整但比例不变。海汇聚成为公司员工持股平台,系公司实际控制人的一致行动人,其中公司董事及高管通过该平台间接持股的,减持股份数不得超过其所持股份总数的25%。公司表示该股东此前作出的持股及锁定承诺均已严格履行,本次减持符合法规要求,不会导致控股权变更或影响公司正常经营,减持计划是否及如何实施存在不确定性,股东将依法依规履行信息披露义务。

富瀚微:关于公司2021年股票期权激励计划预留授予第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告

公司11月7日发布公告,宣布2021年股票期权激励计划预留授予第四个行权期将采用自主行权模式,行权期为2025年11月10日至2026年10月13日。本次可行权股票期权共159,506份,占公司总股本0.07%,行权价格为每份88.47元,涉及31名激励对象。期权股票来源为公司定向发行A股普通股,行权由广发证券承办,激励对象可在有效期内通过券商系统自主申报行权。公司指出,行权完成后总股本预计增加15.95万股,对财务状况及经营成果影响较小,亦不会改变股权结构及控制权;行权所得资金将全部用于补充流动资金。激励对象应自行承担并缴纳个人所得税,未在有效期内行权的期权将自动失效并注销,公司将在后续定期报告中披露行权进展及股份变动情况。

汇创达:关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

公司11月7日发布公告,称控股股东、实际控制人李明、实际控制人董芳梅及其一致行动人宁波通慕合计持股比例因三项事项变动并触及5%整数倍:其一,公司依据证监会批复向李明发行658.1834万股募集配套资金,股本由1.66391145亿股增至1.72972979亿股,三者合计持股比例由54.55%升至56.28%;其二,李明通过协议转让将940.4318万股,转让给张淑媛,合计持股降至50.84%;其三,宁波通慕于2025年11月6日通过集中竞价减持145.76万股,占总股本0.84%,三者合计持股降至8648.6474万股,占总股本50.00%,从而触及5%整数倍。本次权益变动不涉及要约收购,不改变公司控股股东与实际控制人,不影响公司治理与持续经营;宁波通慕的减持与已披露计划一致,尚未完成,公司将按规定持续披露。

中英科技:关于股东减持股份预披露的公告

公司11月7日发布公告,控股股东及实际控制人的一致行动人马龙秀计划因个人资金需求,在公告披露15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过58万股公司股份,占总股本0.7713%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得,减持价格将根据市场情况确定,若期间公司发生送股或转

增股本等事项，减持数量将作相应调整。马龙秀此前在公司上市时曾承诺36个月内不转让首发前股份，并已严格履行，无违规情形。本次减持不会导致公司控制权变更，不会影响治理结构和持续经营，减持计划的时间、数量及价格仍存在不确定性，公司将持续督促股东依法依规履行信息披露义务。

领益智造:关于调整购买资产方案的公告

公司11月7日发布公告，宣布调整此前拟通过发行可转债及支付现金方式收购江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权的购买资产方案。调整后，公司将撤回向深交所提交的相关申请文件，并改为以现金方式收购江苏科达控制权，交易完成后江苏科达将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。本次调整系公司基于市场环境及资本运作规划的审慎决策，不涉及可转债发行及募集配套资金事项，也不构成重大资产重组或关联交易。公司董事会和独立董事会议已审议通过该议案，相关调整事项在股东大会授权范围内，无需再次审议。公司表示，此举不会对现有经营产生不利影响，也不会损害中小股东利益，并承诺自公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组。调整后的具体交易安排仍需进一步论证和审批，存在实施不确定性，公司将根据进展及时披露相关信息。

五、下周重要事件提示

表 3：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	2025 年 6G 发展大会	11.13-11.14	北京市	中国信息通信研究院、IMT-2030 (6G) 推进组、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管理委员会
2	第十二届电子工程与技术国际会议 (ICEET 2025)	11.14-11.16	海口市	海南大学、海南大学信息与通信工程学院
3	第二届电子信息工程与智能通信国际研讨会 (EIC 2025)	11.14-11.16	厦门市	集美大学
公司会议				
序号	公司名称	会议名称		会议时间
1	中电港	股东大会举办		2025-11-14
2	亿道信息	股东大会举办		2025-11-14
3	康强电子	股东大会举办		2025-11-14
4	天津普林	股东大会举办		2025-11-14
5	拓邦股份	股东大会举办		2025-11-14
6	*ST 东晶	股东大会举办		2025-11-14
7	欧菲光	股东大会举办		2025-11-14
8	领益智造	股东大会举办		2025-11-14
9	瀛通通讯	股东大会举办		2025-11-14

10	传艺科技	股东大会举办	2025-11-14
11	伊戈尔	股东大会举办	2025-11-14
12	力源信息	股东大会举办	2025-11-14
13	南大光电	股东大会举办	2025-11-14
14	民德电子	股东大会举办	2025-11-14
15	弘信电子	股东大会举办	2025-11-14
16	中富电路	股东大会举办	2025-11-14
17	本川智能	股东大会举办	2025-11-14
18	矽电股份	股东大会举办	2025-11-14
19	盛景微	股东大会举办	2025-11-14
20	盛美上海	股东大会举办	2025-11-14
21	世华科技	股东大会举办	2025-11-14
22	生益电子	股东大会举办	2025-11-14
23	思特威	股东大会举办	2025-11-14
24	富信科技	股东大会举办	2025-11-14
25	莱尔科技	股东大会举办	2025-11-14
26	慧为智能	股东大会举办	2025-11-14
27	晶赛科技	股东大会举办	2025-11-14
28	深圳华强	股东大会举办	2025-11-13
29	广合科技	股东大会举办	2025-11-13
30	惠威科技	股东大会举办	2025-11-13
31	奥海科技	股东大会举办	2025-11-13
32	联建光电	股东大会举办	2025-11-13
33	光弘科技	股东大会举办	2025-11-13
34	利安科技	股东大会举办	2025-11-13
35	海能实业	股东大会举办	2025-11-13
36	中英科技	股东大会举办	2025-11-13
37	唯特偶	股东大会举办	2025-11-13
38	天山电子	股东大会举办	2025-11-13
39	天键股份	股东大会举办	2025-11-13
40	苏州天脉	股东大会举办	2025-11-13
41	生益科技	股东大会举办	2025-11-13
42	世运电路	股东大会举办	2025-11-13
43	八亿时空	股东大会举办	2025-11-13
44	英集芯	股东大会举办	2025-11-13
45	长阳科技	股东大会举办	2025-11-13
46	南芯科技	股东大会举办	2025-11-13
47	思瑞浦	股东大会举办	2025-11-13
48	深纺织 A	股东大会举办	2025-11-12
49	和而泰	股东大会举办	2025-11-12
50	茂硕电源	股东大会举办	2025-11-12
51	三利谱	股东大会举办	2025-11-12

52	百邦科技	股东大会举办	2025-11-12
53	奕东电子	股东大会举办	2025-11-12
54	致尚科技	股东大会举办	2025-11-12
55	福日电子	股东大会举办	2025-11-12
56	华正新材	股东大会举办	2025-11-12
57	盛洋科技	股东大会举办	2025-11-12
58	乐鑫科技	股东大会举办	2025-11-12
59	臻镭科技	股东大会举办	2025-11-12
60	有研硅	股东大会举办	2025-11-12
61	上海合晶	股东大会举办	2025-11-12
62	鼎佳精密	股东大会举办	2025-11-12
63	戈碧迦	股东大会举办	2025-11-12
64	奥迪威	股东大会举办	2025-11-12
65	维信诺	股东大会举办	2025-11-11
66	奥拓电子	股东大会举办	2025-11-11
67	台基股份	股东大会举办	2025-11-11
68	维峰电子	股东大会举办	2025-11-11
69	中船特气	股东大会举办	2025-11-11
70	大为股份	股东大会举办	2025-11-10
71	朗特智能	股东大会举办	2025-11-10
72	信音电子	股东大会举办	2025-11-10
73	新亚电子	股东大会举办	2025-11-10
74	三孚新科	股东大会举办	2025-11-10

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		限售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
301359.SZ	东南电 子	2025-11-10	8,119.43	12,017.60	3,586.39	29.84	6,839.67	56.91	首发原股东限售股份
001298.SZ	好上好	2025-11-10	931.74	29,683.60	15,408.49	51.91	16,340.22	55.05	首发原股东限售股份
001309.SZ	德明利	2025-11-10	62.22	22,688.63	16,037.66	70.69	16,087.59	70.91	股权激励限售股份
688432.SH	有研硅	2025-11-10	74,005.54	124,762.11	50,756.57	40.68	124,762.11	100.00	首发原股东限售股份
688322.SH	奥比中 光	2025-11-10	4.44	40,114.42	29,219.59	72.84	29,224.03	72.85	股权激励一般股份
300604.SZ	长川科 技	2025-11-10	393.68	63,046.59	48,556.07	77.02	48,949.74	77.64	股权激励一般股份
002922.SZ	伊戈尔	2025-11-11	27.07	42,310.31	37,502.88	88.64	37,529.95	88.70	股权激励限售股份
001389.SZ	广合科 技	2025-11-14	97.00	42,568.75	15,024.21	35.29	15,121.21	35.52	股权激励限售股份

数据来源：Choice，金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。